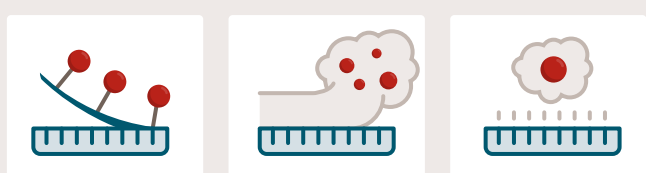


# 革新的な材料で高度な技術的課題を解決する

半導体ノードの微細化が 10 nm 以下に進むと、材料とプロセス統合の改善が必要となります。インテグリスは、業界の技術革新を実現するために、スラリー、特殊配合薬品、CMP パッドコンディショナー、およびブラシの開発に総合的なアプローチをしています。

## 歩留まりの向上とプロセスの安定性を実現する技術

### ウェットケミカル



**No.1** CMP 後洗浄液のサプライヤー

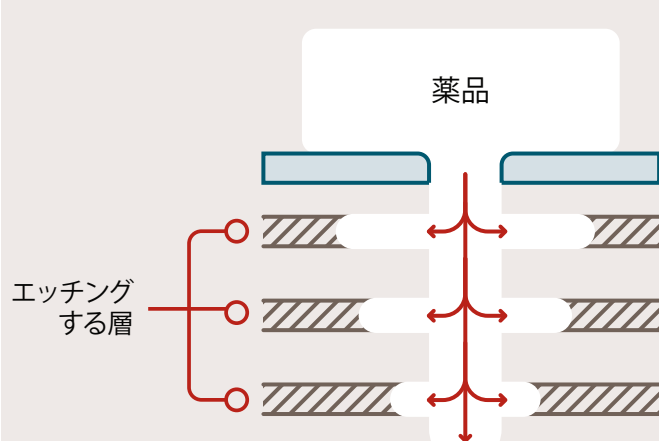
**No.1** 超硬質面材料向け研磨用スラリーのリーダー

**1,600 万** 過去 20 年間に出荷された CMP 後洗浄液の量 (単位:ガロン)

**>1,000 万** 世界中に供給されたエッチング後残渣洗浄液の量 (単位:ガロン)

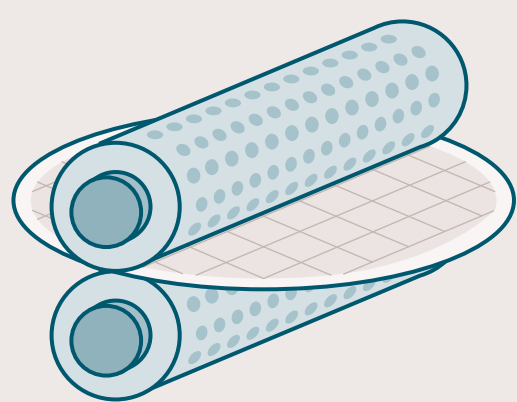
**>2 億 5,000 万** 世界中に供給されたエッチング後残渣洗浄液の量 (単位:ガロン)

### エッチング用ケミカル



**推奨** 3D NAND における選択的エッチング液のサプライヤー

### CMP ブラシ

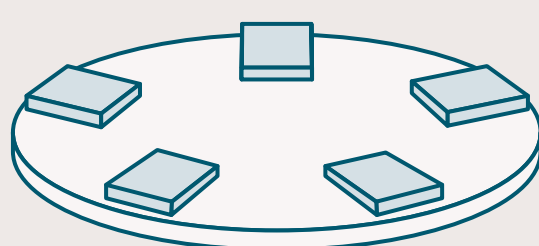


**2.5 倍** ブラシの長寿命化

**80 %** 微量金属の低減率

**表面改質** 電荷斥力

### CMP パッドコンディショナー



**>2.5 倍** パッドの長寿命化

**>100 %** スクラッチの低減率

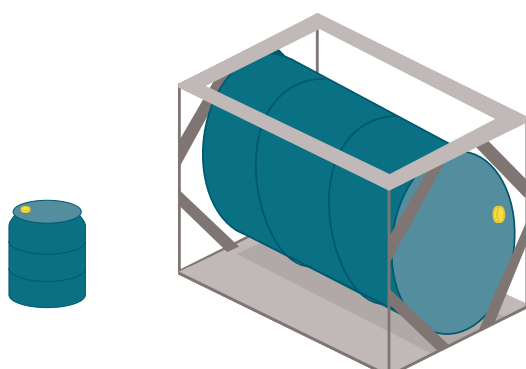
**改善** プロセスの安定性

## 技術革新と最先端科学のプロセス



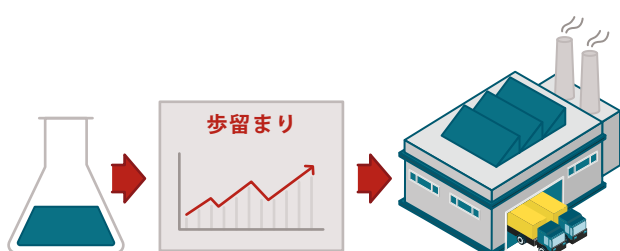
### 研究開発

半導体メーカーや装置メーカーと緊密に連携し、社内分析、合成、精製、300 mm ウェーハプロセスでの実績を活かした最適化されたソリューションを提供します。



### 配送

インテグリスのワールドクラスの製品は、最適な性能と総所有コストを改善するためにカスタマイズされたろ過を行い、高純度容器で配送されます。



### スケールアップ

確立されたプロセスに従って、研究開発から大量生産に迅速にスケールアップし、正確な DOE 法と SPC 分析を使用してお客様の仕様に対応します。

## グローバルな対応力



**5** 製造施設

**4** テクノロジーセンター

お客様の近くに配置された拠点の数



**>20** 統合とアプリケーションに関する幅広い知識を持つグローバルの専門技術者数



**>500** 難しい統合の課題を解決し、歩留まりの高い製造を実現するために必要な薬品と材料についてのグローバル知識を持つ専門家たちの累積経験年数

詳細はこちらから

[www.entegris.com/spi-innovation](http://www.entegris.com/spi-innovation)